

Z DUO 系列铣刀

- 专为将极硬层与很软层材料相结合的多组分材料而开发的
- 可同时加工碳化硅层 (SiC) 和铜等材料
- 克服了传统铣刀遇到极硬层材料时的限制
- 具有立方氮化硼 (CBN) 或金刚石区域以提高性能
- 通过对金刚石涂层进行轮廓化处理，从而具有很高的灵活性
- 可以防止铜等软材料造成的堵塞



更高级的工具





Z DUO 系列铣刀

树立电子元件加工新标准

发现 LUKAS Z DUO 系列铣刀中的创意

正在申请专利的 Z DUO 系列铣刀是大量研发工作的成果，旨在应对加具有极硬层的多组分材料时面临的挑战。凭借金刚石涂层，它甚至能够高效地加工要求最苛刻的材料，例如与铜相结合的碳化硅层 (SiC)。

该铣刀将硬度和最高的精度集于一身：与传统铣刀不同的是，铣削区域的中央有一个环形圈，它由立方氮化硼涂层或可选的金刚石涂层制成。这意味着甚至可以一次性加工具有极硬层和很软层的层状材料。



根据需要可以购得：
请与我司的负责开发或
销售的同事联系。